

la lettre arcsis

PROVENCE - ALPES- CÔTE D'AZUR

JUILLET 2006 - N°19 - PÉRIODIQUE TRIMESTRIEL D'INFORMATION

EDITO

SAME change de dimension



Depuis neuf ans, SAME (Sophia-Antipolis MicroElectronics) s'impose comme un événement incontournable pour l'industrie microélectronique européenne. Accueillant

plus d'un millier de visiteurs désireux d'actualiser leurs connaissances dans un domaine en constante évolution, cette conférence combine des présentations sur l'état de l'art et des formations sur des sujets techniques de haut niveau. Elle intègre également des débats où managers et scientifiques, parmi les plus grands experts mondiaux, y discuteront cette année de l'impact de la complexité de conception sur les applications finales ainsi que des solutions techniques offertes aux problèmes posés par la télévision sur téléphone portable. Organisé par l'association SAME en partenariat avec ARCSIS, le forum se tiendra les 4 et 5 octobre 2006 aux Espaces Antipolis, à Sophia-Antipolis.

Le choix de ce nouveau cadre permettra de recevoir un public plus nombreux et de faire face à la demande croissante de stands. Très spacieux, le hall d'exposition abritera dans les meilleures conditions sponsors de la manifestation et start-up invitées pour présenter leurs produits et stratégies. Plus de 20 exposants et partenaires financiers ont déjà confirmé leur participation. En exclusivité, la plate-forme Conception de CIM PACA prévoit de détailler, avec ses doctorants, le contenu et l'état d'avancement des travaux de recherche de leurs projets R&D.

L'intensité des travaux n'empêche pas la convivialité. Le dîner de prestige célébrera un anniversaire : les 20 ans de la microélectronique à Sophia-Antipolis, en présence des acteurs historiques de cette formidable aventure. Enfin, le rituel cocktail de clôture récompensera la meilleure contribution de cette édition, et affichera notre solidarité avec l'autre rive méditerranéenne, par la remise d'un don à l'association « Rencontres Africaines ».

SAME 2006 peut encore accueillir des sponsors, des exposants et des visiteurs. Nous vous attendons. → www.same-conference.org

Jacques-Olivier Piednoir
Président de SAME

L'ÉVÉNEMENT

FORUM OCOVA 2006

Les PME innovantes tiendront la vedette

La troisième édition du forum OCOVA « Objets Communicants et Valorisation » se déroulera au château de Charance à Gap le 12 septembre 2006. Les PME pourront y découvrir tous les outils à leur disposition pour jouer pleinement leur rôle dans les processus d'innovation.

En 2005, le forum OCOVA avait réuni environ 150 participants, cadres et dirigeants d'entreprises, responsables de laboratoires de recherche ou d'organismes de développement, représentants de collectivités locales... ainsi que le Ministre délégué à l'aménagement du territoire, Christian Estrosi. Le 12 septembre prochain, à Gap, la manifestation devrait en rassembler au moins autant. Mais si, l'an dernier, les pôles de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (SCS), en PACA, et Minalogic, en Rhône-Alpes, labellisés par l'Etat deux mois plus tôt, se trouvaient naturellement au centre des débats consacrés aux solutions multi-applicatives dans les transports et la vie quotidienne, le thème évoluera sensiblement lors de cette 3^{ème} édition. OCOVA 2006 s'intéressera résolument à la place des PME dans les projets innovants et la dynamique des pôles, avec un éclairage particulier sur les outils de développement à leur disposition.

Comme lors des éditions précédentes, les interventions seront denses et de haute tenue. Toutefois, le programme ménagera une place importante à des ateliers de travail favorisant les échanges et les contacts entre acteurs. Après un bilan des performances des PME et une évaluation de leur rôle dans les pôles SCS et Minalogic, le forum explorera la question : « Dispositifs d'appui à l'innovation : réalité ou mythe pour le développement des PME ? ». Une ouverture concrète sur la suite des débats, consacrés aux modalités de mise en œuvre de stratégies d'alliances entre acteurs de la chaîne de valeur : outils d'accès à l'information, offres de compétences, rapprochement offre-demande... La plateforme « Business to Business » d'OCOVA, opérationnelle dès les semaines précédant l'évènement, sera lancée en tant qu'outil d'échanges, de mise en relation et de génération d'opportunités

d'affaires à l'occasion du forum et servira de support pour la totalité des débats.

Le reste de la journée s'articulera autour de quatre ateliers de travail thématiques : « Vie quotidienne », « Risque et Environnement », avec un accent spécifique sur l'intégration des réseaux de capteurs, « Santé », « Loisirs ». Chacun présentera un panorama des avancées technologiques des acteurs de l'industrie et de la recherche au sein des pôles de compétitivité. Une session de rencontres « one to one », formelles et informelles, entre offreurs de solutions, scientifiques et grands comptes utilisateurs, complètera l'évènement.



Comme précédemment, OCOVA 2006 accueillera au Domaine de Charance les principaux laboratoires et plateformes de

recherche impliqués dans les deux pôles (CEA-Leti, CNRS L2MP, CIM PACA, INRIA...), des représentants des grands groupes industriels (Alcatel, Amadeus, Atmel, France Telecom R&D, Gemplus, HP, IBM, Philips, STMicroelectronics, TI...), les dirigeants des pôles SCS et Minalogic. Les dirigeants des PME les plus dynamiques et innovantes de la filière, mais aussi les utilisateurs de « solutions communicantes sécurisées » y sont attendus. Sans oublier tous les « accompagnateurs de performances » : les structures et associations d'appui au développement (OSEO-Anvar, DRIRE, Méditerranée Technologies, ARCSIS, Telecom Valley, Baby Smart, chambres consulaires...), les institutions publiques (Préfecture de région, Conseil régional, Conseil Général), les spécialistes du management (Euromed, EDHEC...) et les organismes de financement (banques, capital risque).

Pierre Vollaire
Organisateur, Vice-Président d'ARCSIS

Les entreprises d'ARCSIS à l'honneur face au Ministre délégué à l'Industrie

Plus de 600 rendez-vous d'affaires organisés en une journée, 600 participants dont 80 investisseurs, 40 grandes entreprises, près de 250 PME innovantes : la 2^{ème} édition du « Forum du financement de l'innovation et de la compétitivité » s'est achevée sur un vrai succès le 11 mai dernier à Marseille, à la grande satisfaction de François Loos, Ministre délégué à l'Industrie, initiateur de cette manifestation. L'événement a mis en avant le pôle Solutions Communicantes Sécurisées (www.pole-scs.org) ainsi qu'une vingtaine de PME régionales dont plus d'un tiers sont membres d'ARCSIS (In Silicio, Secure Machines, Spintron, ASK, Tagsys, Impika, IBS).

Des ouvertures sur le Brésil...

Responsable de la Mission PME du pôle SCS et du Business Développement chez ARCSIS, Vincent Boisard a pris part, du 30 avril au 6 mai, à la mission organisée par le Conseil Régional PACA à Sao Paulo et Rio de Janeiro au Brésil. Il a pu rencontrer plusieurs centres de recherche dont le CenPra en Microélectronique, des universités, des organismes financiers, des pépinières d'entreprises et des PME, en vue de définir des axes de collaborations scientifiques, technologiques et industrielles :

- Développement de projets en partenariat avec les centres de recherche brésiliens (financement de 50% du coût du projet par les organismes locaux de soutien à l'innovation)
- Développement de partenariats commerciaux ponctuels entre PME
- Mise en place d'un projet bilatéral structurant à fort potentiel économique : Traçabilité RFID dans le domaine de l'Agrobusiness.

...et à San Francisco, aux Etats-Unis.

En visite en France, Delphine WILSON, Chef de Secteur Electronique de la Mission Economique de San Francisco, a souhaité rencontrer des entreprises régionales de la microélectronique. Un programme de rendez-vous sur 2 jours a été organisé à Rousset et Sophia Antipolis. Membres d'ARCSIS, Innova Card, Inside Contactless, SPS, Spintron, Kemesys, ASK ont saisi cette opportunité.

Vincent BOISARD
Responsable Business Développement
vincent.boisard@arcsis.org



Un atelier de travail sur NEMESYS

Le 11 mai dernier, à l'initiative d'ARCSIS et du consortium NEMESYS, plus de 50 experts industriels et scientifiques de PACA, Rhône-Alpes et de l'Europe, se sont réunis à STUniversity pour un atelier de travail sur la technologie NEMESYS (Non-volatile Embedded Memory for Systems on Silicon). Ce projet MEDEA+ a pour objectif de développer les mémoires non volatiles embarquées inférieures à 100 nm sur silicium. NEMESYS permet d'intégrer sur une même puce la mémoire nécessaire au stockage d'informations confidentielles et le processeur de traitement logique et arithmétique indispensable au cryptage et au décryptage de ces informations.

Ce type de mémoire de plus en plus miniaturisée constitue le composant essentiel des applications sécurisées. Partenaires industriels de ce projet, Atmel, Infineon, Philips et STMicroelectronics produisent 70% de la demande mondiale de puces pour les cartes sécurisées. Afin de se doter des meilleurs atouts en matière de développement de cette technologie face à leurs compétiteurs (dont Samsung Electronics), ils sont épaulés dans le projet par les deux grands centres européens de développement en microélectronique : IMEC Leuven et le LETI Grenoble. Les présentations de l'atelier sont disponibles sur le site ARCSIS.

Michel Madore
Responsable des programmes européens, ATMEL Rousset

Conception

La ferme de calcul de la plate-forme est maintenant opérationnelle. Une première PME utilise déjà nos outils de conception. De nouveaux projets souhaitent entrer dans la plate-forme TYM (Time Yield Modeling) et « Trust me Vip » pour un démarrage à la prochaine rentrée universitaire. Les investissements de 2006 sont actés. L'appel d'offres est en cours de finalisation. La Plate-Forme s'associera au forum SAME 2006 et communiquera sur ses avancées.

Caractérisation

Le 1^{er} équipement industriel de la plate-forme vient d'être installé : il s'agit du Micro-Auger représentant un investissement de 1 M€. Le deuxième équipement industriel lourd (un D-SIMS, 1^{er} équipement du genre en région PACA) est arrivé début juin. Les deux sont hébergés provisoirement chez STMicroelectronics.

Pour la tranche d'investissements 2006, les demandes de soutien financier auprès du Conseil Régional, de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix et du FEDER sont en cours de traitement.

En novembre prochain, la plate-forme s'associera aux 9^{èmes} Rencontres Scientifiques et Techniques d'ARCSIS dédiées à la « Sensibilité des Dispositifs Avancés aux Contaminations ».

Micro-PackS

Deux étapes importantes viennent d'être lancées :

- L' Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne recrute à Gardanne pour la plate-forme un ingénieur et un technicien salle blanche.
- Avec le support de la Communauté du Pays d'Aix et du fonds européen FEDER, la plate-forme investit 1,6 million d'euros dans une ligne industrielle de prototypage de micropackaging souple. Cet équipement permettra de manipuler des tranches de silicium de 50 microns et moins. La plate-forme s'associera aux Journées Micropackaging en novembre 2006 sur le sujet de l'Electronique plastique et du packaging souple.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Erich Palm, Président d'Arcsis

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL

Céline Auger

COORDINATRICE DE RÉDACTION

Corinne Joachim

RÉDACTEUR

Eric Collomb

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO

Jean-Luc Autran, Vincent Boisard, Martine Bricaire, Nathalie Cottat, Bruno Delepine, Minh Duc Tran, Armelle Favery, Pascal Galand, Corinne Joachim, Michel Madore, Olivier Marrone, Erich Palm, Jacques-Olivier Piednoir, Laurent Roux, Françoise Sommer, Michel Thomas, Florence Vireton, Pierre Vollaire.

PUBLICATION SOUTENUE PAR

Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le Conseil Général du Var, la Mairie de Rousset, le Ministère de la Recherche et les adhérents d'ARCSIS.

CRÉDIT PHOTOS

ARCSIS, ARD, Biophy Research, SAME.

CRÉATION ET MISE EN PAGE

Etincelles
infos@etincelles-studio.com

IMPRESSION

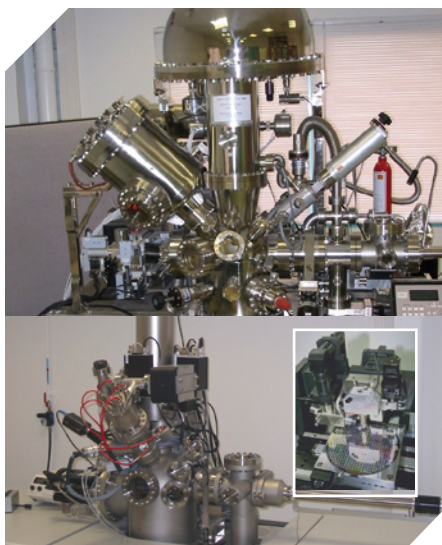
Espace : 04 91 78 58 78



BP 19, place Paul Borde, 13790 ROUSSET
tél. : 04 42 53 81 50 - fax : 04 42 53 81 51

Biophy Research SA, un partenaire de poids pour CIM PACA

Spécialiste de l'analyse de surface pour traquer propriétés et imperfections des matériaux, Biophy Research va mettre ses équipements de pointe au service de la plate-forme Caractérisation de CIM PACA.



Haut : Spectromètre de Photoélectrons XPS
Bas : Spectromètre d'ions secondaires ToF-SIMS
Vignette : AFM - Dimension 3100

Née en 1993, Biophy Research SA, après Marseille, a choisi en 2002 Fuveau, près du pôle de Rousset, pour se développer. L'industrie microélectronique constitue une cible privilégiée de partenariat pour ses activités d'analyse et de traitement de surfaces. S'appuyant sur une équipe d'ingénieurs et de chercheurs confirmés en sciences des surfaces, la PME inventorie quantitativement et qualitativement les propriétés des matériaux (adhérence, mouillabilité, biocompatibilité, lubrification...) et révèle leurs éventuels défauts (contaminations, usure...). Un enjeu de premier ordre pour les fabricants de circuits intégrés, toujours en quête d'une amélioration de leurs performances et de leur compétitivité dans l'industrialisation de leurs innovations. Confrontée à des exigences de plus en plus pointues, Biophy Research s'est dotée d'un parc d'équipements haut de gamme (spectromètres haute résolution, microscopes...) et de logiciels d'interprétation de données. Elle entend aujourd'hui faire profiter de son expertise la plate-forme Caractérisation du Centre Intégré Microélectronique (CIM) de PACA dont elle est l'un des membres fondateurs. L'entreprise souhaite en effet mutualiser certains matériels (mi-

croscopie AFM, spectromètre ToF-SIMS...) dont les caractéristiques apparaissent particulièrement adaptées à la résolution des problématiques de fabrication et de contrôle qualité des semi-conducteurs.

Outre ces prestations analytiques, Biophy accompagne de nombreux clients dans leur démarche R&D par des contrats spécifiques et programmes de recherche nationaux et européens. Ses méthodologies sont en permanence optimisées par la mise en œuvre de contrats d'études et de R&D avec le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie (MENRT), avec l'Union européenne (PCRD), mais aussi par l'accueil de thèses et la veille technologique. Certifiée ISO 9001 et bénéficiant d'un agrément SRC (Société de Recherche sous contrat) de l'ANVAR, Biophy ne limite cependant pas l'étendue de son savoir-faire à la microélectronique puisqu'elle répond aussi aux cahiers des charges d'autres industriels intéressés par sa capacité d'analyse des surfaces de matériaux polymères, métallurgiques ou verriers...

Françoise Sommer
PDG de Biophy Research

NEWS... NEWS... NEWS...

Le Centre Microélectronique de Provence enrichit son offre de formation

En octobre prochain, la première promotion du Mastère SISA (Systèmes Intégrés Sécurisés & Applications) verra le jour au sein des formations de 3^{ème} cycle du Centre de Microélectronique de Provence (CMP). Ce programme post-ingénieur résulte d'une collaboration entre académiques (CMP, le LIRM Montpellier et Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Luminy) et industriels (Atmel, Gemplus, Philips, STMicroelectronics, Texas Instruments, et Trusted Logic). Il s'adresse à de jeunes ingénieurs ainsi qu'aux salariés des entreprises du secteur (modules de cours disponibles « à la carte »). Recouvrant trois grandes thématiques, la cryptographie, la conception de composants sécurisés et l'ingénierie des applications, le Mastère contribuera au développement de l'industrie régionale en matière de technologies de sécurisation des puces.

Pour la 8^{ème} année consécutive, le Mastère en Technologie et Management de Production en Microélectronique ouvrira ses portes à une vingtaine d'étudiants français et étrangers. Ce Mastère, développé par le CMP, l'Ecole Généraliste d'Ingénieurs de Marseille et STUniversity, couvre les principaux aspects de la fabrication des circuits intégrés, de la conception à l'assemblage et du management de la production à la fiabilité.

→ Contact : Olivier MARRONE, tél. : 04 42 53 54 69, marrone@emse.fr

Le L2MP et STMicroelectronics lancent la plateforme ASTEP

Comme introduit dans l'article de la lettre N°18, le L2MP (Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence) et la société STMicroelectronics (Crolles), après deux années de R&D, ont mis en service la plateforme ASTEP (Altitude SEE Test European Platform) dédiée à la caractérisation des circuits microélectroniques dans l'environnement radiatif terrestre. Installée à 2 522m d'altitude sur le Plateau du Pic de Bure dans les locaux de l'IRAM (Institut de Radio Astronomie Millimétrique), la plateforme abrite un équipement lourd de test, unique au niveau européen, capable d'étudier l'impact des neutrons atmosphériques sur les mémoires sur puces. ASTEP héberge également depuis peu un deuxième banc de test conçu par la société américaine Xilinx dans le cadre de l'expérience Rosetta. Ces expériences consistent à exposer à l'environnement radiatif naturel un grand nombre de circuits, tels des composants mémoires capables de stocker des informations sous forme de 0 et de 1, et de vérifier périodiquement le contenu de ces mémoires pour détecter d'éventuelles erreurs (un 0 transformé en 1 ou vice-versa) induites par l'interaction du rayonnement avec le composant.

→ Jean-Luc Autran - L2MP-CNRS - Philippe Roche - STMicroelectronics - www.l2mp.fr/astep

Ion Beam Services récompensée pour son activité export

Sous-traitante de procédés de fabrication de composants microélectroniques pour des clients mondiaux et concepteur-fabricant d'équipements d'implantation ionique, Ion Beam Services, à Peynier, s'est vue décerner fin mars à l'occasion du salon Class Export le trophée spécial du jury. Cette PME d'une cinquantaine de personnes, présidée par Laurent Roux (ex-président d'ARCSIS), réalise 50% de son chiffre d'affaires à l'export et exploite également, depuis 1998, une unité en Ecosse, dans la Silicon Glen. Ses marchés sont principalement européens, mais IBS intervient aussi en Asie (Singapour, Taïwan, Chine) et en Amérique du Nord où elle vient de livrer, au Canada, un accélérateur de particules. La récompense salue les efforts d'une société toujours en mouvement, malgré un contexte euro-dollar défavorable pour l'industrie européenne. → www.ion-beam-services.com

BOÎTE À OUTILS

Découvrir les savoir-faire microtechniques

Micronora 2006

Avec 20 000 m² de surfaces d'expositions, plus de 800 exposants et 15 000 visiteurs, Micronora est le plus grand salon européen des microtechniques (automatisation, usinage, découpage, décolletage...). Il se tiendra à Besançon, du 26 au 29 septembre. Vitrine privilégiée des innovations et savoir-faire de toute une filière, la manifestation se veut aussi une véritable plate-forme de communication industrielle pour des marchés variés : automobile, microélectronique, télécommunications, équipement...

→ www.micronora.com

Evaluer ses circuits intégrés

IOLTS 2006

L'essor des technologies submicroniques et nanométriques a démultiplié la demande industrielle de solutions de test en ligne dans la fabrication des produits électroniques. Douzième édition de la conférence internationale sur le test en ligne des circuits intégrés, « IEEE International On-Line Testing Symposium » se tiendra au Lac de Come, en Italie, du 10 au 12 juillet, afin d'explorer les dernières évolutions du domaine.

→ <http://tima.imag.fr>

Joli succès pour IIT 2006

La 16^{ème} conférence internationale sur l'implantation ionique IIT 2006, tenue à Marseille du 12 au 16 juin 2006, a rassemblé plus de 400 ingénieurs et scientifiques spécialisés. Si plus de la moitié d'entre eux étaient européens, 30% venaient des Etats-Unis et 15% de l'Asie. La manifestation leur a permis de prendre notamment connaissance de 200 posters de haut niveau et d'échanger avec une vingtaine d'exposants. Co-organisée cette année par ARCSIS, en partenariat avec la société IBS, les Universités de Surrey et de Provence, ainsi que d'autres partenaires tels que Atmel, STMicroelectronics, les Universités de la Méditerranée et Paul Cézanne, la conférence IIT constitue dans son domaine la réunion mondiale de référence. Le séminaire de formation de 3 jours qui l'a précédée a pour sa part réuni plus de 50 participants.



VERBATIM

Erich Palm, président d'ARCSIS

« ARCSIS confirme son désir d'ouverture »

ARCSIS a tenu le 2 juin dernier son assemblée générale. Son président trace les perspectives pour les prochains mois et évoque la nouvelle dimension de l'association.



Quels sont les grands enjeux actuels et à venir d'ARCSIS, après l'année de structuration et de consolidation que fut 2005 ?

Prioritairement, il me paraît important de poursuivre et d'accroître nos actions de soutien et de valorisation de nos membres, en matière de relations « BtoB » et d'intelligence économique. ARCSIS accompagnera également la montée en puissance des trois plates-formes mutualisées de R&D du Centre Intégré de Microélectronique. Un comité de suivi et de pilotage s'est mis en place. Il va falloir aussi songer à diffuser les premiers résultats des travaux conduits par ces plates-formes, par exemple, à l'occasion des nombreux événements nationaux ou internationaux auxquels nous prenons part, comme organisateur ou exposant. Nous devons en effet améliorer la visibilité et la lisibilité de nos initiatives par davantage de pédagogie, car les apports de la microélectronique au dynamisme de cette région, en raison de la complexité des technologies développées, restent souvent mal appréhendés. Dans le même esprit, ARCSIS jouera pleinement son rôle au sein du pôle de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées, avec la volonté de renforcer les synergies entre les différents acteurs de la filière, mais aussi entre les projets qu'ils portent.

ARCSIS devient-elle désormais un interlocuteur incontournable dans la microélectronique française et européenne ?

Elle tend, en tout cas, à le devenir. Le 2 juin, nous avons approuvé une modification de nos statuts afin d'ouvrir ARCSIS à des partenaires industriels et académiques des régions limitrophes comme membres associés. Nos adhérents participent à des projets réunissant des entreprises, des laboratoires, des universités, issus parfois de régions différentes, voire d'autres pays. En élargissant ses frontières au-delà de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'association prend en compte ces coopérations extra-régionales. ARCSIS gagne également en notoriété par sa capacité à mettre sur pied des rencontres professionnelles internationales. En 2006, de la 7^{ème} conférence européenne AEC-APC à Aix-en-Provence, en mars, à la conférence IIT 2006 à Marseille, en juin, jusqu'aux Journées MicroPackaging, programmées fin novembre, il s'en tiendra près d'une dizaine, chacune réunissant des centaines de participants. La satisfaction que ces derniers manifestent participe à la reconnaissance de notre professionnalisme, de notre efficacité et de nos projets.

Matériaux Innovants et Procédés Associés

La 6^{ème} édition des Rencontres technologiques Matériaux Innovants et Procédés Associés se tiendra les 27 et 28 septembre 2006 à l'Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var (83). Consacrées aux matériaux polymères et composites et aux matériaux fonctionnels, elles permettent à l'ensemble des professionnels de la filière (fournisseurs, laboratoires, bureaux-d'études, utilisateurs, centres techniques...) d'échanger sur les processus de développement et d'innovation, l'éco-conception, les transferts de technologies.

Le colloque présentera également cette année les centres européens de transfert technologique dans le secteur de la plasturgie. L'exposition proposera par ailleurs une sensibilisation à l'éco-conception, à travers la présentation de matériaux d'origine naturelle et de produits éco-conçus.

Pour obtenir le programme complet, réserver un stand ou proposer un poster :

→ **Contact : Armelle FAVERY**
Tél. : 04 93 00 43 84
favery@carma.fr
www.salonmatériauxpaca.net

Smart Event 2006

La prochaine édition de « Smart Event » se déroulera du 19 au 22 septembre 2006 à Sophia-Antipolis. Ce Forum international scientifique et stratégique interprofessionnel de la Carte, de l'Identité électronique (eID) et de l'Ambient Intelligence (Aml) est soutenu par plus de 35 institutions internationales du secteur. Il s'articulera autour de 4 conférences : « E-Smart », « World e-ID », « Ambient Intelligence Developments » (AmlD) et « Smart University ». Près de 200 conférenciers et intervenants et 550 délégués de 45 pays sont attendus.

→ **Renseignements :**
www.strategiestm.com
Tél. : +33 (0)1 46 34 45 54

Interconex 2006

Le Parc des expositions Micropolis de Besançon accueillera du 26 au 29 septembre prochains un double événement : Interconex 2006 et Micronora (voir page 3). Pour le comité technique, en charge de l'organisation, cette association se justifie par la nécessité de mieux valoriser les complémentarités des secteurs microélectroniques et micromécaniques, dans les procédés de fabrication des composants microélectroniques, les technologies de packaging et d'interconnexion, l'intégration des dispositifs mécatroniques, les microcapteurs ou les systèmes microélectron-mécaniques (MEMS).

Pour connaître le programme détaillé et la liste des exposants,

→ **Contact : Florence Vireton**
Tél. : 01 39 67 17 73
E-mail : imapsfrance@imapsfrance.org
www.imapsfrance.org